

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Д. Мак-Грат.** Проектирование беспроводных чипсетов 5G для беспилотных автомобилей № 6, с. 68
- М. Макушин, И. Черепанов.** Перспективы развития автономного транспорта № 7, с. 70
- Ш. Шпинци.** HDI-технологии для беспилотных автомобилей № 7, с. 88
- Дж. Триггс, Д. Бурк.** Проблемы и решения технологии подключения автомобильных камер № 7, с. 94

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

- А. Крылова.** От идеи до продвижения: инструменты маркетинга гражданской продукции № 1, с. 66
- Ю. Ковалевский.** Совместное заседание ОАО «РЖД» и Секции № 9 МРГ при коллегии ВПК РФ № 1, с. 72
- Ю. Ковалевский.** «Бережливое производство»: базовые методы и тонкая настройка. IV Конференция «Развитие производственных систем и повышение производительности труда в холдинговой компании АО «Российская электроника» № 1, с. 78
- Ю. Ковалевский.** Искусственный интеллект: от мемристора до применения систем. Стратегический диалог и секция научно-технической конференции по теме искусственного интеллекта на форуме «Микроэлектроника 2019» № 1, с. 86
- В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский, В. Мейлицев.** productronica и SEMICON Europa 2019: автоматизация и скорость. Часть 2 № 2, с. 32
- В. Ежов.** «Неделя электроники с Siemens»: цифровые технологии как конкурентное преимущество № 5, с. 30
- Ю. Ковалевский.** Ответы на новые вызовы в сфере электромагнитной совместимости IX Всероссийская научно-техническая конференция «Электромагнитная совместимость» № 8, с. 38
- Ю. Ковалевский.** Отечественная ЭКБ как важнейший элемент стратегии развития отрасли. IX Всероссийская научно-техническая конференция «ЭКБ-2020» № 9, с. 60
- Ю. Ковалевский.** Правовое регулирование беспилотного транспорта. Заседание Секции оборонно-промышленного комплекса Экспертного совета Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности № 10, с. 42
- А. Кищинский.** СВЧ-компоненты на основе технологии нитрида галлия: взгляд изнутри № 10, с. 44

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- С. Назаров, А. Барсуков.** Оптимизация параллельных вычислений бортовых систем реального времени. Часть 1 № 10, с. 110

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

- А. Гусаров.** Универсальная сетевая платформа для сбора информации с датчиков и управления приборами учета № 5, с. 90
- Дж. Толлефсон.** «Алло! Меня слышно?» Как не допустить разрывов соединения в критической IoT-аппаратуре № 6, с. 64
- Э. Родланд.** Как адаптировать существующее решение для использования в Интернете вещей № 7, с. 104
- Р. Беддор.** Шесть способов организовать подключение к Интернету для приложений IoT № 10, с. 118

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- М. Макушин.** Искусственный интеллект: проблемы и перспективы развития № 9, с. 62
- Н. Андреева, В. Лучинин, Е. Рындин.** Мультимодальные нейроморфные модули на основе многоуровневой мемристорной логики № 9, с. 72
- С. Щаников, А. Зуев, И. Борданов, С. Данилин, В. Лукоянов, Д. Королев, А. Белов, Я. Пигарева, А. Gladkov, А. Пимашкин, А. Михайлов, В. Казанцев.** Искусственная нейронная сеть на основе мемристорных устройств для двунаправленного адаптивного нейроинтерфейса № 9, с. 86

КОЛОНКА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- № 2, с. 19; № 3, с. 39; № 4, с. 21; № 5, с. 21; № 6, с. 20; № 7, с. 26; № 8, с. 25; № 9, с. 29; № 10, с. 25

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- А. Бакли.** Мы стремимся стать ключевым технологическим партнером трансформации электронной отрасли России № 1, с. 12
- А. Григорьева.** Важнейшая задача для внедрения отечественных технологий – координация между производителем и заказчиком № 2, с. 10
- К. Саито.** Электронные микроскопы давно перестали быть экзотикой на производстве № 3, с. 12
- В. Беспалов, Д. Собянин.** Сегодня Siemens – единственная компания на рынке, которая предлагает комплексный подход к цифровизации разработки и производства как машиностроительной, так и электронной продукции № 3, с. 20
- Д. Велеславов.** Наше контрактное производство растет, но мы ищем идеи, чтобы усилить этот рост № 3, с. 28
- А. Соболев.** Российский рынок контрактного производства глазами одного из его участников № 3, с. 32
- П. Морошек.** Разработка РЭА, начиная с ЭКБ, – это как технические, так и экономические преимущества для наших заказчиков № 4, с. 10
- Д. Бэбби.** Выбирая поставщиков, сужать их спектр до крупных производителей самых передовых компонентов очень рискованно № 4, с. 16
- В. Куклев.** В преддверии юбилея: три века за 100 лет № 5, с. 10
- Е. Липкин.** Наш долг – проявить максимальную солидарность и помочь предприятиям в адаптации к новой реальности № 5, с. 16
- С. Легостаева.** Для развития отечественной вычислительной техники мы должны действовать вместе № 6, с. 12
- А. Адамов.** Мы готовы стать платформой для обеспечения цифрового суверенитета страны в области искусственного интеллекта № 7, с. 10
- Р. Мангушева.** Выставке – быти! № 7, с. 18
- Н. Фокин.** Измерительное и мониторинговое оборудование компании Signal Hound: от лаборатории вуза до станции спутниковой связи № 7, с. 22
- О. Жданев.** Системный подход и понимание приоритетов потребителя – основа эффективного технологического развития № 8, с. 10

П. Куцко. Внедрение новых технологий управления производством – условие развития НИИЭТ	№ 8, с. 18
А. Шумахер. Не останавливаться на достигнутом, опираясь на сильный инженерный и научный потенциал	№ 9, с. 10
А. Переверзев. Университет как эффективная площадка для развития инноваций	№ 9, с. 16
В. Трещиков. От волоконно-оптических транспортных систем связи к радиофотонике	№ 9, с. 24
А. Тихонов. Для обеспечения КИИ отечественными доверенными решениями объективных препятствий нет. Нужна только воля к победе	№ 10, с. 10
В. Симонов. Новая комплексная научно-техническая программа по развитию микро- и радиоэлектронной промышленности	№ 10, с. 18

КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

А. Чернышов. Встраивание электронных компонентов – общие рекомендации	№ 2, с. 130
В. Исаев. Взаимосвязь параметров, влияющих на надежность печатных плат	№ 5, с. 128
О. Барина. Нюансы использования метода обратного высверливания при разработке печатных плат	№ 7, с. 162

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

Я. Россоский. Осциллографы АКП-4133 и АКП-4133 / 1 с полосой пропускания 16 ГГц. Часть 2	№ 1, с. 124
Л. Лемешко, Д. Богаченков. Автоматизированные системы для испытаний на ЭМС на основе программной платформы R&S ELEKTRA	№ 2, с. 70
А. Мирсков, С. Шилаев. Сертификация программного обеспечения высокотехнологичных промышленных изделий	№ 2, с. 76
М. Макушин, В. Мартынов. Некоторые проблемы современной метрологии в микроэлектронике	№ 2, с. 80
Н. Лемешко, А. Патшин. Оценка качества функционирования спутниковых навигаторов при наличии помех с использованием векторных генераторов R&S SMW200A и R&S SMBV100B. Часть 1	№ 3, с. 122
А. Скребнев. Экранированные и безэховые камеры как альтернативные измерительные площадки и средства защиты информации	№ 3, с. 126
А. Мирсков, С. Шилаев. О вибродиагностике технически сложных промышленных объектов	№ 3, с. 132
Н. Лемешко, А. Патшин. Оценка качества функционирования спутниковых навигаторов при наличии помех с использованием векторных генераторов R&S SMW200A и R&S SMBV100B. Часть 2	№ 4, с. 78
А. Смирнов, К. Басалаев, Ю. Занин. Испытательная система для тестирования устойчивости к излучаемым помехам	№ 4, с. 86
Махасин Фра, В. Беляев, И. Леонисова. Электромагнитное загрязнение от радиочастотных источников и их воздействие на человека	№ 6, с. 70
А. Иванов. Современное состояние поддержки периферийного сканирования отечественной электронной компонентной базой	№ 6, с. 76

М. Циммерман, Р. Такеда, Б. Хользингер, М. Хоуз.

Анализатор динамических характеристик силовых полупроводниковых приборов	№ 8, с. 82
Р. Розанов. Электромагнитные шумы и способы их подавления при электрическом контроле устройств до этапа корпусирования ...	№ 8, с. 88
А. Пивак, А. Репин. Использование техники фазовых компенсаций для изменения формы и спектра сигналов	№ 8, с. 94

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ

В. Емельянов. Повышение устойчивости к стресс-миграции пленочных структур на основе алюминия в микроэлектронике	№ 1, с. 152
М. Макушин, В. Мартынов. Производственные технологии микроэлектроники: проблемы развития. Часть 1.	№ 3, с. 76
Д. Суханов. Расширяя границы существующих систем безмасковой литографии: технология MLE™	№ 4, с. 114
М. Макушин, В. Мартынов. Производственные технологии микроэлектроники: проблемы развития. Часть 2.	№ 5, с. 120
А. Камышева. Сравнительный анализ вольт-амперных характеристик ионоселективных полевых транзисторов с мембранами на основе оксидов тантала, ниобия и титана	№ 6, с. 106
А. Камышева. Разработка маршрутной технологии изготовления ионоселективных кремниевых МОП-транзисторов ...	№ 7, с. 150
В. Беляев. Квантовые точки: свойства, технологии, рынок	№ 7, с. 152
А. Адамова, Т. Цивинская. Прецизионный сенсор давления на базе монокристаллического кремния	№ 9, с. 104
В. Беляев, Х. Язбек. Применение технологии квантовых точек для электрооптических и оптоэлектронных устройств	№ 9, с. 110

МИКРОМОДУЛИ И МИКРОБЛОКИ

К. Райнболд, К. Фелтон, Д. Вертянов, К. Никеев. Проектирование многокристалльных модулей и систем в корпусе ...	№ 2, с. 144
А. Хохлун, С. Чигиринский. Гетерогенная интеграция как один из путей выхода российской микроэлектроники из кризиса	№ 5, с. 54
Д. Вертянов, С. Евстафьев, П. Вилкунд, В. Сидоренко. Технологии внутреннего монтажа бескорпусных элементов и особенности проектирования микросистем со встроенными кристаллами. Часть 1.	№ 6, с. 96
Д. Вертянов, С. Евстафьев, П. Вилкунд, В. Сидоренко. Технологии внутреннего монтажа бескорпусных элементов и особенности проектирования микросистем со встроенными кристаллами. Часть 2.	№ 7, с. 144

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ПЛИС

Д. Садеков, В. Ежов. Микросхемы программируемой логики Intel FPCA (Altera) для промышленных приложений	№ 1, с. 136
А. Строгонов, П. Городков. Современные тенденции развития ПЛИС: от системной интеграции к искусственному интеллекту	№ 4, с. 46
Д. Антонов, С. Шумилин, А. Ким. Микросхема контроллера видеоадаптера	№ 4, с. 58
Д. Садеков, В. Ежов. Zynq UltraScale+ – адаптируемая интеллектуальная платформа для промышленного Интернета вещей	№ 4, с. 64

С. Белоусов, Б. Мёрдок. Особенности памяти LPDDR5 и ее поддержка	№ 4, с. 70
Д. Знаменский, А. Блинников. Аппаратная поддержка виртуализации архитектуры «Эльбрус»	№ 5, с. 60
С. Рыбаков, Р. Деменко. Виртуализация подсистемы прерываний микропроцессоров «Эльбрус»	№ 5, с. 68
А. Кожин, Е. Кожин, Д. Шпагилев. Исследование топологий сетей на кристалле многоядерных процессоров с архитектурой «Эльбрус»	№ 7, с. 132
Я. Петричкович, Т. Солохина, Д. Кузнецов, Л. Меньшенин, А. Беляев, В. Гусев, И. Федорюшкин, Ф. Путря, А. Функнер, С. Фролова, С. Лавлинский, О. Шаталова, В. Сафанюк, С. Корольков, И. Аликберов. «Скиф» – система на кристалле для мобильных и встраиваемых систем связи, навигации и мультимедиа	№ 8, с. 120
Д. Джонсон. Использование RISC-V для упрощения регистрации данных в космосе	№ 9, с. 118
Я. Петричкович, Т. Солохина, Д. Кузнецов, Л. Меньшенин, Ф. Путря, А. Функнер, Е. Белогубцев, Е. Гришаев, Е. Омелянчук, С. Фролова, С. Лавлинский, С. Груздев. «Элиот» – система на кристалле для Интернета вещей	№ 10, с. 122

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Китайские электронные компоненты и российский рынок: специфика и возможности	№ 3, с. 58
COVID19: что происходит в отрасли и что будет дальше?	№ 4, с. 36
Выбор САПР ППТ: правильно ли мы понимаем, как не отстать от времени?	№ 10, с. 34

НАДЕЖНОСТЬ И ИСПЫТАНИЯ

А. Домени. Экспериментальная проверка метода диагностического контроля электрических соединений	№ 2, с. 92
А. Гербин. Типовая методика ускоренных испытаний ЭКБ на надежность	№ 2, с. 100
Ф. Васильев, А. Домени. Особенности рентгеновского контроля дефектов электрических соединений печатных плат	№ 4, с. 138
В. Громов, А. Дракин, А. Школин, В. Зотин. Опыт внедрения нового автоматизированного тестового оборудования на производстве АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»	№ 5, с. 74
П. Лысенко. Сертификация СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015: зачем это нужно?	№ 6, с. 36
А. Петровичев. Испытания на воздействие прямого удара молнии на авиационное оборудование	№ 6, с. 38
А. Чиминёв. Печатная плата – ключевой компонент, определяющий надежность конечного продукта	№ 6, с. 42
М. Перлман. 2D Metrology – автоматические 2D-измерения для точного контроля проводников с заданным волновым сопротивлением	№ 6, с. 48
И. Васильев. Особенности измерения удельного и поверхностного сопротивлений четырехзондовым методом	№ 6, с. 52
Р. Латыпов, А. Солдатов, А. Шашмурина, Е. Слепухов, В. Кусков. Технология латентного тестирования – практическое применение	№ 7, с. 180

А. Домени. Обзор методов электрического контроля печатных плат	№ 9, с. 164
---	-------------

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

М. Грихин. Где заказать проектирование печатных плат – фриланс или дизайн-центр?	№ 1, с. 160
А. Соломатин. «Индустрия 4.0» и современный сервис: особенности и тенденции	№ 3, с. 90

ПОРТРЕТ ФИРМЫ

В. Кочемасов. «Радиокомп». Вчера. Сегодня. Завтра	№ 3, с. 72
Полвека опыта и достижений: производству «ТЕХНОТЕХ» – 50 лет! ..	№ 6, с. 32

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В. Ланин, И. Петухов, Л. Драгилев. Ультразвуковая микросварка проволочных выводов больших диаметров при монтаже мощных полупроводниковых приборов	№ 2, с. 152
В. Кармолин. Применение селективной пайки для изготовления сложной мелкосерийной продукции	№ 2, с. 162
Ф. Бараковский, С. Ванцов, Ф. Васильев. Струйный метод получения проводящего рисунка печатной платы	№ 3, с. 108
Ю. Боброва, М. Андроник, В. Орлов. Фотолитография и травление в технологиях высокоплотных печатных плат	№ 4, с. 128
Д. Яковлев. Производство печатных плат из многослойной керамики	№ 5, с. 138
Н. Кульчицкий, А. Наумов, В. Старцев. Охлаждаемые фотоприемные устройства ИК-диапазона на кадмий-ртуть-теллуре: состояние и перспективы развития	№ 6, с. 114
Н. Толочко, В. Ланин. 3D-печать в электронике	№ 6, с. 124
И. Петухов, В. Ланин, И. Тычинская, Г. Ретюхин. Оптимизация технологических режимов лазерной пайки бессвинцовых припойных шариков в 3D-структурах микроэлектроники	№ 8, с. 144
В. Поляков, А. Федосова. «Электроприбор» – мы нацелены на выпуск только качественной продукции	№ 9, с. 154
А. Скупов. Сварка полупроводниковых пластин через полимеры	№ 9, с. 158

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Д. Черняковский, А. Зиновьев, А. Мамаев, К. Юрьев, А. Новичков, С. Жуков, В. Карцев. Реализация режима позиционирования PPP в ГНСС-приемниках компании НТЛаб	№ 3, с. 114
К. Лялин, Ю. Мелёшин, А. Переверзев, М. Хасанов. Повышение разрешающей способности РСА с применением алгоритма многополосной обработки	№ 7, с. 108

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ

Ю. Ковалевский. Востребованность отмывки электронных изделий диктуется растущими требованиями к надежности. Визит в лаборатории аналитических подразделений компании Zestron	№ 2, с. 60
---	------------

Ю. Ковалевский. «Умные» системы становятся частью производств наравне с оборудованием. Визит на сборочно-монтажное производство АО «Рязанский Радиозавод»	№ 3, с. 64
Ю. Ковалевский. Когда процессы настроены на качество и надежность. Визит на производство ООО «Макро ЕМС»	№ 5, с. 34
Ю. Ковалевский. Высокая производительность – это не только большие объемы производства, но и возможность более точного прогнозирования сроков для заказчика. Визит на производство ЗАО «Фортэкс»	№ 5, с. 44
Ю. Ковалевский. «Умное» производство гражданской продукции. Визит на сборочное производство отдела приборостроения АО «НПП «Исток» имени А. И. Шокина»	№ 7, с. 40
Ю. Ковалевский, В. Мейлицев. «Умный» участок мелкосерийной сборки: максимум гибкости, быстрая переналадка, точный учет. Визит на сборочно-монтажное производство АО «НИИ ТМ»	№ 10, с. 54

СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА

В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. Твердотельные СВЧ-переключатели средней и большой мощности. Часть 4	№ 1, с. 142
В. Геворкян, В. Кочемасов, В. Шадский. Генераторы с применением диэлектрических резонаторов. Часть 1	№ 2, с. 114
Р. Алексеев, А. Цоцорин, М. Черных. Мощные СВЧ LDMOS-транзисторы для рабочих частот до 3 ГГц	№ 4, с. 98
В. Геворкян, В. Кочемасов, В. Шадский. Генераторы с применением диэлектрических резонаторов. Часть 2	№ 4, с. 102
В. Беляев. Жидкокристаллические устройства для модуляции терагерцового излучения	№ 5, с. 96
К. Джурицкий, А. Андросов. СВЧ-соединители мм-диапазона. Материалы для опорных диэлектрических шайб	№ 5, с. 100
В. Геворкян, В. Кочемасов, В. Шадский. Генераторы с применением диэлектрических резонаторов. Часть 3	№ 5, с. 112
В. Геворкян, В. Кочемасов. Ферритовые переключатели. Часть 1	№ 6, с. 90
В. Геворкян, В. Кочемасов. Ферритовые переключатели. Часть 2	№ 9, с. 122
В. Кочемасов, А. Сафин, С. Дингес. Твердотельные СВЧ-переключатели с высокой скоростью коммутации. Часть 1	№ 10, с. 70
Д. Садеков. Обзор ВЧ / СВЧ-компонентов Analog Devices: основные категории устройств и области применения	№ 10, с. 84
Р. Хабибуллин. Квантово-каскадные лазеры терагерцового диапазона в России: современное состояние и перспективы	№ 10, с. 90
Д. Красовицкий, А. Филаретов, В. Чальй. Нитридная СВЧ-электроника в России: если еще подождать, уже не догоним	№ 10, с. 94
С. Тарасов, Д. Колесников, Г. Глушков, М. Полуниин, С. Рябыкин, А. Ткачев. Возможна ли замена импортных СВЧ GaN-транзисторов от известных мировых производителей на отечественные аналоги?	№ 10, с. 100

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

В. Громов, П. Ястребов. Новая серия импульсных стабилизаторов напряжения – микросхемы 5320	№ 3, с. 156
В. Ежов. Применение DC / DC-преобразователей QAI51 от Mornsun в схемах управления затворами мощных транзисторов для инверторов солнечных батарей	№ 3, с. 166

А. Павлов. Программируемые источники питания GENESYS+ от TDK-Lambda: высокая мощность в компактном корпусе	№ 3, с. 170
В. Громов, А. Дерябин, В. Смирнов. Радиационно-стойкие, отечественные линейные стабилизаторы напряжения 5321EH01, 5321EH02, 5321EM06	№ 7, с. 138
А. Долгушин, Д. Жикленков, В. Мелешин. Силовая электроника на российских железных дорогах	№ 8, с. 42
М. Макушин. Мощные SiC- и GaN-приборы: перспективы развития	№ 8, с. 46
Ж. Йе. Снижение электромагнитных помех в автомобильных источниках питания	№ 8, с. 60
В. Ежов. Как улучшить тепловые характеристики модульных импульсных источников питания	№ 8, с. 68
Е. Рабинович. Всё, что нужно знать при выборе источника питания для медицинского оборудования	№ 8, с. 72
О. Пчельникова-Гротова. Управление движением фотоэлектрических панелей в солнечной энергетической установке	№ 9, с. 132
В. Хасиев. Как увеличить мощность повышающего преобразователя с помощью универсального расширителя фаз	№ 10, с. 132

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

М. Макушин, В. Мартынов. Некоторые аспекты развития САПР	№ 1, с. 90
А. Строгонов, М. Кривчун, П. Городков. Обзор программных средств с открытым исходным кодом для исследования современных архитектур ПЛИС Xilinx	№ 1, с. 100
К. Розе, Д. Радченко. Инструмент физической верификации нового поколения IC Validator NXT	№ 1, с. 108
Ю. Леган. Разработка электрической схемы в иерархической форме. Часть 2	№ 1, с. 116
Д. Онг. Интегрированная программная платформа ускоряет внедрение инноваций	№ 1, с. 122
А. Строгонов. Применение Altera DSP Builder системы Matlab / Simulink для разработки имитационной модели КИХ-фильтра на параллельной распределенной арифметике	№ 3, с. 176
М. Грихин. Программные решения Cadence для параллельного проектирования печатных плат	№ 4, с. 122
Е. Иванова. Решения Synopsys для различных направлений: что нового?	№ 7, с. 168
Ю. Завалин, Ю. Ковалевский. Выбор САПР ПП: как не отстать от времени?	№ 8, с. 102
П. Демидов, А. Фень. Altium Concord Pro. Управление проектами	№ 8, с. 110
П. Демидов. Облачная платформа Altium 365: как упростить взаимодействие проектирования и производства электроники	№ 9, с. 140
П. Виклунд, Д. Вертянов, И. Беляков, С. Евстафьев. Особенности проектирования гибких и гибко-жестких печатных плат. Часть 1	№ 9, с. 148
П. Виклунд, Д. Вертянов, И. Беляков, С. Евстафьев. Особенности проектирования гибких и гибко-жестких печатных плат. Часть 2	№ 10, с. 136

СОБИТИЕ НОМЕРА

О. Казанцева. Электроника в России: будущее отрасли.

По материалам пленарного заседания конференции № 1, с. 32

В. Ежов, Ю. Ковалевский, В. Мейлицев. productronica

и SEMICON Europa 2019: автоматизация и скорость. Часть 1 № 1, с. 38

Ю. Ковалевский. Стратегия развития электроники в России

в контексте общемировых технологических тенденций.

Пленарная часть XIX Отраслевой научно-технической

конференции радиоэлектронной промышленности

и Международного форума «Микроэлектроника 2020» № 9, с. 42

СХЕМОТЕХНИКА

А. Воронин. Аналого-цифровое преобразование

в измерительном канале с кремниевым детектором № 4, с. 92

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

А. Гаранин. Сложные задачи поверхностного монтажа

и гибкие решения EuroPlace № 3, с. 94

О. Китаев. Процессы отмычки и влагозащиты

в радиоэлектронном производстве № 3, с. 100

В. Андриянов, С. Сидельников, С. Горячкин. Привод

вращения и перемещения затравки для установок выращивания

монокристаллов кремния методом Чохральского № 6, с. 110

В. Косевской, М. Кваша. Опыт разработки и производства

СВЧ-микросборок и модулей на основе СКМ – отечественной

системы низкотемпературной совместно спекаемой керамики № 10, с. 64

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

И. Рахмилевич, О. Хомутская, С. Ванцов. Коллективное

использование производственных мощностей в условиях

цифровой экономики № 5, с. 144

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С. Ванцов. Роботизация производства: направления

и некоторые проблемы № 7, с. 176

Я. Тарасов, С. Тынянкин. Интеллектуальные

информационные системы контроля производства и поставки

радиоэлектронной продукции № 8, с. 140

ЭКОНОМИКА + БИЗНЕС

А. Фомина, М. Макушин. Проблемы оптимизации цепочек

поставок подрядчиков Пентагона № 1, с. 164

М. Макушин, И. Черепанов. Хай-тек vs COVID-19... № 4, с. 146

И. Покровский. Как перейти от борьбы за доминирование

к совместному развитию № 6, с. 134

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

С. Пескова. Высокоскоростные краевые разъемы 3М № 3, с. 148

Ф. Комиссаров. Реле от компании Fanfar: высокое качество

по конкурентным ценам № 3, с. 152

Р. Ромашко. Соединители Harting для однопарного Ethernet –

от замысла к международному стандарту № 7, с. 112

ЭЛЕКТРОНИКА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. Ухов, В. Герасимов, Л. Селиванов, В. Симон. Повышение

безопасности и надежности умных замков № 6, с. 60

Я. Петричович, Т. Солохина, А. Беляев, Д. Кузнецов,

Л. Меньшенин, Ф. Путря, А. Функнер, С. Фролова, В. Гусев,

Е. Янакова. RoboDeus – 50-ядерная гетерогенная СпК для

встраиваемых систем и робототехники № 7, с. 52

Поставка медицинской аппаратуры и другого оборудования

для борьбы с COVID19 в рамках выполнения гражданского

заказа предприятиями ОПК № 7, с. 64

А. Грибин. АО «ЗПП» – поступательное движение к рынку

гражданской электроники № 7, с. 66

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

Д. Садеков, В. Ежов. Датчики Texas Instruments: эффективные

решения для всех видов измерений № 2, с. 106

Д. Махин, Г. Морозова. Унифицированная серия

низковольтных многослойных варисторов № 3, с. 136

Ф. Комиссаров. Надежные MELF-резисторы от компании

Firstohm № 3, с. 140

А. Цветков. Новые разработки АО «ПКК Миландр» в области

генераторов частоты № 3, с. 142

В. Бельков, А. Цоцорин, И. Семейкин, М. Черных.

Мощные СВЧ и переключающие транзисторы на основе

нитрида галлия № 5, с. 78

В. Лучинин, О. Бохов, И. Мандрик, В. Старцев, А. Смирнов,

П. Афанасьев, М. Аньчков, А. Пудова, В. Никонова,

С. Шевченко. Конформно интегрируемая электронная

компонентная база гибкой печатной электроники для

Интернета людей № 5, с. 82

Е. Павлюкович. Оперативная память от GSI Technology:

рекордные параметры и высокая надежность № 6, с. 80

А. Котюков, А. Никонов, А. Заславский, Ю. Иванов.

Особенности применения кварцевых генераторов с высокой

температурной стабильностью № 6, с. 86

М. Соколов, В. Ежов. Полимерные конденсаторы Kemet:

надежные решения для гражданской электроники № 7, с. 116

Д. Махин, И. Дорда, К. Кармалева. Серия керамических

помехоподавляющих фильтров Б36 для поверхностного монтажа ... № 7, с. 122

А. Гуменюк. Новый быстродействующий 16-разрядный АЦП

компании «Миландр» № 7, с. 126

П. Непрокин. Инерциальная система на основе сигнального

процессора АО «ПКК Миландр» и микроэлектромеханических

датчиков № 8, с. 130

В. Никитин. Ключевые факторы надежности модулей Пельтье

на примере продукции компании CUI Devices № 8, с. 136

К. Мёрфи. Выбор подходящего датчика для предиктивного

технического обслуживания № 9, с. 96

С. Боков, А. Саутина, Ю. Фенюк. Общий структурный

анализ применимости электронной компонентной

базы отечественного и иностранного производства

в радиоэлектронной промышленности № 10, с. 106